

薄膜で高い接着力を発現！！

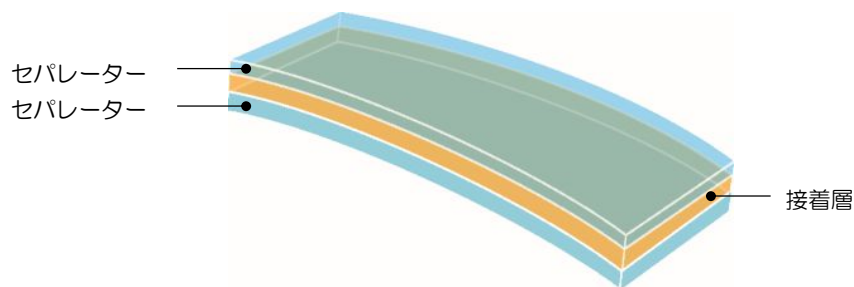
基材レス両面接着フィルム

ビワボンドNT

特長・用途

- ・ディスプレイやタッチパネル周辺などの光学部材やFPC、CCLなどの電子部材にご使用頂ける基材レスの両面接着フィルムです。
- ・単層薄膜の接着層である為、部材の軽量化、薄膜化が可能です。
- ・ガラスに対して高い粘着力を発現する粘着タイプや耐ハンダ性に優れた熱硬化タイプをラインアップしております。

製品構成



特性

◎ 粘着タイプ

特性	NT5A1(P)	
接着層	特殊アクリル粘着	
粘着力[N/25mm] (#50PET貼合)	対SUS	6.8
	対ガラス	7.0
透明性[%] (ガラス板貼合)	全光線透過率	92.0
	ヘイズ	0.4

◎ 熱硬化タイプ

特性	NT5E1	NT3A1
接着層	変性エポキシ樹脂	変性アクリル樹脂
接着強度[N/cm]	#25PI/#12Cu	8.0
	#25PI/#15AL	5.5
耐ハンダ性	260℃×30sec. 浮き、剥がれ無し	浮き、剥がれ無し

※ PI：カプトン100H Cu：電解銅箔（黒化処理面） AL：軟質アルミ箔（ケシ面）

※ 試験片作製条件

NT5E1 150℃×3kg/cm²×1min.プレス+150℃×30min.加熱

NT3A1 160℃×3kg/cm²×1min.プレス+160℃×30min.加熱

※ 測定値は代表値であり、保証値ではありません。

※ このカタログの記載内容は、予告なく変更することがあります。

株式会社 **タカラ** インコーポレーション

製品のお問い合わせは

プラスチック事業部

大阪販売課

06-6261-4965

東京販売課

03-3242-3325

名古屋販売課

052-581-1244

20161101(2)